

株主メモ

事業年度 1月1日から12月31日まで

定時株主総会 3月

基準日 定時株主総会 12月31日
剰余金の配当 期末 12月31日
中間 6月30日

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先・照会先 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号(〒541-8502)
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
電話(通話料無料) 0120-094-777

公告の方法 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。
(<https://www.daiichi-seiko.co.jp>)
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求、配当金の振込指定、その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

ホームページのご案内

<https://www.daiichi-seiko.co.jp>

第一精工

検索

最新のトピックスをはじめ、業績報告や会社情報などをわかりやすくご案内してまいります。



株主・投資家情報ページ



第57期 年次報告書

2019年1月1日～2019年12月31日



第一精工株式会社

新社長就任ご挨拶

株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昨年6月28日より、小西前社長の後を受け代表取締役役に就任いたしました。

年次報告書をお届けするにあたり、謹んでご挨拶いたしますと共に、今後も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 **土山 隆治**



Q 第57期(2019年12月期)の業績について

ノートパソコン向けコネクタが下半期に急回復し、業績を牽引。

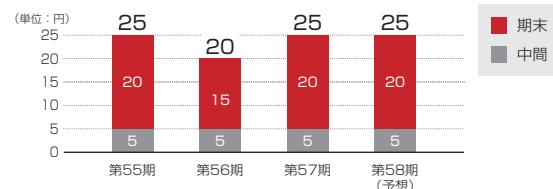
まず、電気・電子部品事業では、モバイル端末の販売不振やノートパソコン向けのCPU不足等から上半期は低調に推移いたしました。下半期に入りCPU不足の解消とWindows7のサポート終了に伴うノートパソコン更新需要の拡大により部品需要が急回復したことから、当社の主力商品である細線同軸コネクタやBoard to Boardコネクタ等のフルシールドコネクタが大きく売上を伸ばしました。HDD関連部品は、サーバー向けの需要に回復傾向が見られましたが、全体としてはHDDメーカーの在庫調整継続の影響を受け低調でした。その一方で、5G(次世代移動通信システム)へのサービスに向けて、当社は、高周波向けフルシールドコネクタを、いち早く市場投入し販売をスタートしました。

自動車部品事業は、世界的に自動車販売が伸び悩んだものの、電子化の進展による部品需要増大の恩恵を受け、燃費、環境、安全性能の向上に寄与する車載用センサが好調でした。また、耐振・耐熱性に優れたSMTコネクタは、LEDヘッドライト向けに採用車種が拡大し、自動車部品事業全体では売上レコードを7期連続で更新することができました。

設備事業は、世界的な景気減速を背景として、半導体メーカーに設備投資を先送りする動きが見られたことから、低調に推移しました。

以上のように電気・電子部品事業におけるパソコン向けコネクタが業績を牽引し、売上高540億円、営業利益15億円、経常利益13億8千万円、親会社株主に帰属する当期純利益9億円と増収増益を達成することができました。この結果を受け、期末配当金を1株当たり5円増配の20円、中間配当を含む年間配当金を25円とさせていただきます。

配当金の推移



業績ハイライト

売上高	54,019百万円 (前期比 2.6%▲)
営業利益	1,505百万円 (前期比109.4%▲)
経常利益	1,382百万円 (前期比109.4%▲)
親会社株主に帰属する当期純利益	925百万円

Q 第58期(2020年12月期)の重点戦略について

未来に向けてリソースを最適化し、ダントツ商品を拡充していきます。

■ 電気・電子部品事業

今期より5G(次世代移動通信システム)が世界中で本格的に展開されていくことから、電波を送受信する通信基地局をはじめ、IoT(物のインターネット)の展開が加速し、あらゆる分野で大量なデータを速いスピードで処理できる通信装置が必要となります。当社はこの好機を生かして高周波、高速伝送に優れた細線同軸コネクタやBoard to Boardコネクタを開発し受注拡大に向けて取り組んでまいります。

また、新商品分野では、トルクセンサ「エストルク」が多くの人協働ロボットメーカーや産業機器メーカーから引き合いを頂いており、エストルクを活用したロボットハンドなどの拡販に注力いたします。さらに法医学機器や航空機のエンジンに使用するパーツ、医療、介護分野等へのさまざまな商品の新規採用をいただいております。これからも精密加工技術を生かした新商品の開発を目指してまいります。

■ 自動車部品事業

「CASE」のキーワードのもと、これからの自動車は電動化や自動運転支援システム等の普及に伴い、今後益々電子化が進むことから新たな部品需要が拡大すると予想されます。当社は車載用センサをはじめとする電装部品のビジネスと共に、電子部品で培ったノウハウと、車載コネクタのノウハウを融合した差別化された新商品の開発を行い、次世代モビリティ市場での受注拡大と新規アプリケーション参入を目指します。

■ 設備事業

車載用パワーデバイスのニーズである半導体パッケージの大型化と民生向けの超薄型化に対応したニューモデル「GP-PRO SP-G」を今期より販売いたします。車載向けの高い品質レベルをクリアするノウハウに加えて、パッケージの薄型化を実現する「CCFC」金型との組み合わせにより、自動車分野での拡販と民生市場での販売を強化してまいります。

■ MEMSデバイス

昨年の「CEATEC AWARD 2019」において、匂いを「見える化」するセンサ「nose@MEMS」が、デバイス&テクノロジー部門準グランプリを受賞いたしました。食品・飲料・介護をはじめとしたさまざまなシーンで、これまでに世の中になかった「匂いの見える化」が注目されています。

現在、多数のお客様より試作依頼を受けており、今春より販売をスタートいたします。

商号及びコーポレートブランドを「I-PEX」に統一いたします。(2020年8月1日より)

精密金型の専門メーカーとして1963年に創業した当社は、金型微細加工技術の研鑽にはげみ、さらにコネクタ事業やセンサ事業などにも拡大し、部品受託製造と提案型メーカー双方の機能を併せ持つ企業として成長してきました。今後、時代のニーズのさらに一歩先を行く、新しい価値を創造する「ものづくりソリューションエキスパート」として持続的な成長を目指す姿を明示するとともに、グローバルでのブランド認知の拡大を意図し、社名とコーポレートブランドを「I-PEX(アイベックス)」に統一いたします。

技術力を結集することで次世代技術を開発し未来の利益を創出いたします。

2020年は、生産能力増強を目的として、福岡県小郡市に取得していた65,000㎡の用地にて新工場DOC(仮称)の第1期運用を開始いたします。ここに技術部門を集結させることで、技術者の横断的なシナジー効果を見込んでおります。技術やノウハウを継承する教育施設としての機能も有し、学び舎として社員の未来を担う人材の育成にも活用することで、当社の継続的な企業価値の向上に繋げてまいります。

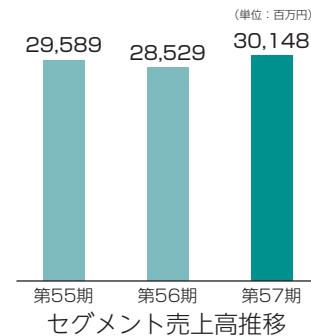
株主の皆様には今後とも当社グループへのご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。

第58期計画

● 売上高	● 経常利益	● 親会社株主に帰属する当期純利益
575 億円	24 億円	16 億円

電気・電子部品事業

より正確に、より緻密に。
「つなぐ技術」が
ここにはあります。



コネクタ及び同関連部品

主にノートPC、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末向けにコネクタ(接続部品)を開発・製造し、世界市場に展開しています。最先端技術や規格に適合するコネクタをいち早く開発して市場をリードすることに力を入れており、Thunderbolt™3やUSB3.1 Type-Cなどの規格を採用する高性能電子機器に当社のコネクタが多数採用されています。5G(次世代移動通信システム)、IoT、自動車、医療機器やロボット、ドローンなど幅広い市場において高速伝送ソリューションでお客様のニーズにお応えします。



イメージ

HDD用機構部品

データセンターのサーバーやゲーム機などの記憶装置として、大容量が進むHDD(ハードディスクドライブ)には今後も根強い需要が見込まれています。当社は、お客様との共同開発により世界で初めて量産化した超精密樹脂部品ランプなど、進化が続くHDDに不可欠の機構部品を供給しています。



ランプはディスク面が接触により傷つくことを防ぐため、データを読み書きする磁気ヘッドを待機格納させる部品です。

👍 未来のダントツ

5Gアプリケーション向けの新しい小型コネクタで未来の通信技術を支えます

NOVASTACK®35-HDN

スマートフォンやルーター、AR/VRデバイスといった5G対応製品において、高周波伝送は勿論のこと高速デジタル信号の伝送にも優れた性能を発揮します。独自のシールド構造により、高いノイズ耐性・アイソレーション性能を実現し、さらに既存のモデルから基盤占有面積53%減の小型化に成功しました。



👍 未来のダントツ

「エストルク」の量産供給ラインアップ拡充

2017年より、安川電機様の人協働ロボットHCシリーズにご採用いただいている静電容量型トルクセンサ「エストルク」が新たに「新機種MOTOMAN-HC20DT」にも採用されました。

また、昨年リリースしたエストルク応用製品「ES-Gripper」「ES-Hand」が、大手ロボットメーカーの正式オプション認定を受けました。特にコネクタ嵌合品質にこだわる自動車業界やハーネス業界へのニーズにも対応しています。

*世界初!
静電容量型トルクセンサ



Electrostatic Capacitance Torque Sensor
ESTORQ



人協働ロボット
MOTOMAN-HC20DT

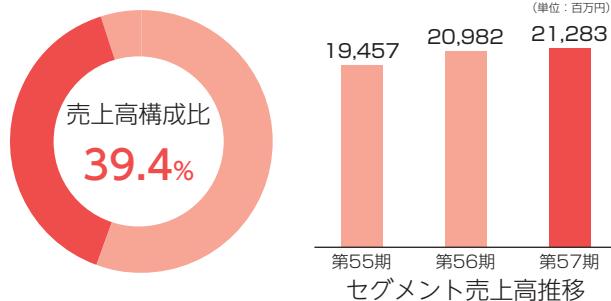
*当社調べ

自動車部品事業

移動を支える先端へ、
信頼の成形システムが
安全へと導きます。



クルマは今や、電子機器の集合体といっても過言ではありません。安全かつ快適な走行のために過酷な条件下でも性能を維持する高感度センサが必需品となっています。また、衝突回避支援システムや自動運転技術の導入に伴いさらに電子制御化が進むクルマには他の電子機器同様、コネクタ(接続部品)などの電子部品が多数使用されています。当社は、センサやコネクタをはじめ各種制御ユニットなど、様々な車載向けソリューションを提供しています。



■各種センサ

エンジンのクランクやカムの回転角と速度を検出し、点火タイミングや燃料噴射の制御に利用することでCO₂の排出抑制や燃費向上などに貢献するセンサ。このほか吸気圧センサや車輪速センサなどクルマの制御に欠かせない部品を供給しています。



高温125℃対応 熱と振動に強いSMTコネクタ
高機能化に応える多極タイプを開発



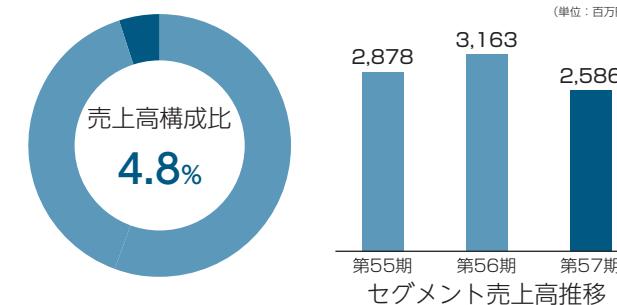
本体BOX部に高強度の内蔵パネを組み込むことで、高い接続信頼性を実現。

設備事業

半導体量産に欠かせない
モールドイングを
高精度かつスムーズに。

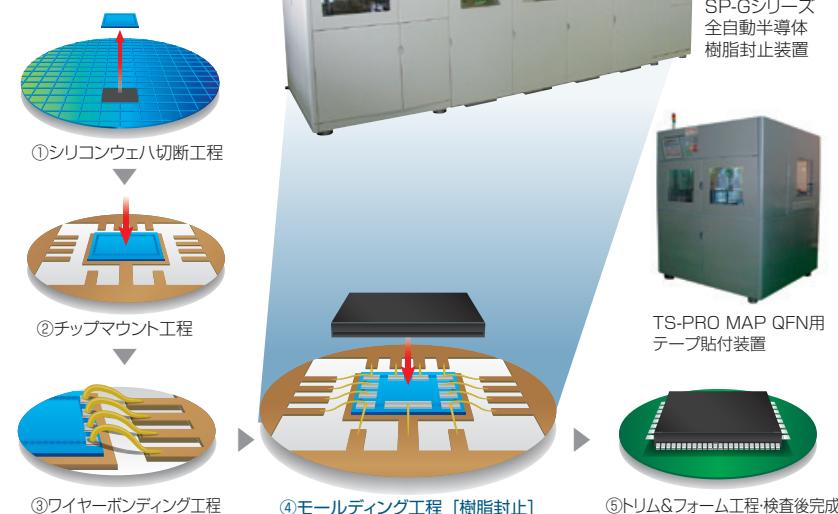


1980年、当社は精密金型技術を活かし、世界で初めて全自動半導体樹脂封止装置を発売しました。以来、国内外のお客様に装置を納入しながら技術の向上を図り、現在では半導体製造関連装置、樹脂成形周辺機器なども供給しています。大判化、薄型高密度などお客様の多用化するニーズにこれまで培った独自のソリューションでお応えし、PC、モバイル、車載、LEDなどの幅広い業界で実績と信頼を積み重ねています。



■半導体生産工程

半導体ができるまで



GP-PRO SP-G series

3つのポイント

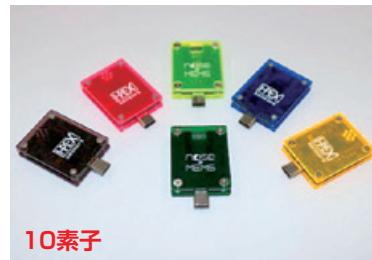
- | | | |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1
製品品質を高める
粉塵対策 | 2
安定生産を実現する
IoT対策 | 3
DUALPOT対応による
大型モジュール成形 |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|

オートモールド30年の歴史と実績
お客様の課題解決のためにアップグレードを重ねてきた「SPシリーズ」から、最新鋭機「SP-G」が誕生しました。徹底した粉塵対策を施し、民生用ICから車載用IC、IoT機器まで、幅広い高品質ニーズに対応します。



20素子

さまざまな匂いを識別できる
nose@MEMS



10素子

身近な匂いを手軽に計測できる
noseStick



スマホで簡単計測

MEMS匂いセンサ 販売目前

2019年10月に開催されたCEATEC 2019（国内最大規模の電機・情報技術の総合展示会）において、匂いセンサ「nose@MEMS」がデバイス&テクノロジー部門の準グランプリを獲得しました（凸版印刷(株)様との共同応募）。センサの小型化により、いままで実現できなかった多様な潜在ニーズを掘り起こした点が高く評価されました。今春の販売に向け準備も急ピッチで進んでいます。



※完成イメージ図

- ①既存棟の改修(仮称DOC1,DOC2) →2020年 5月
- ②新工場建設(仮称DOC3) →2021年10月

公募増資により約49億円の資金を調達

IoTの進展や5Gの普及によるコネクタ需要の増大、自動車の電動化・電子制御化に伴う部品需要の増大に備え、福岡県小郡工場の近隣に取得済の大学跡地を整備し、小郡工場、大刀洗工場とともに「ものづくり拠点」化して生産能力を強化するトライアングル構想を進める目的に調達資金を活用してまいります。



社名変更のお知らせ グローバルで存在感のある企業をめざして、第一精工は、「I-PEX」へ



I-PEXは、【Innovative Product development & Engineering solutions Expert(ものづくりソリューションエキスパート)】を意味し、I-PEXとして、グローバル市場で閃きや驚きという価値を提供してまいります。

2020年8月1日、当社は、目指す姿を明示するとともに、グローバルでのブランド認知の拡大を意図し、I-PEX株式会社（英文表記：I-PEX Inc.）へ社名を変更し、あわせてコーポレートブランドもI-PEXに統一いたします。

これを契機に、グループの全従業員が「I-PEX」のもとで一丸となり、独自の技術、商品、ソリューションを提供することで、世界で信頼され、愛されるグローバルブランドへと成長させてまいります。

また、同時に経営理念についても見直しを行い、CI（コーポレート・アイデンティティ）、ビジョン、タグラインを新たに策定いたしました。当社がこれまで培ってきたものづくりDNAを基盤に、時代のニーズのさらに一歩先に行く、新しい価値を創造する「ものづくりソリューションエキスパート」として持続的な成長を目指してまいります。

TODAY

「ちゃんとする」
超精密部品メーカー

NEXT

「ちゃんとする+その先をつくる」
閃きと驚きを創造する企業

CI、ビジョン、タグライン

CI

- 常に世界が興奮するフィールドを拓く
- 人、知恵、技術をつないで最先端をひらく、ひろげる
- 製造から創造による閃きと驚きを

ビジョン

精密かつ完璧にこだわるものづくりを超えて
ライフスタイルの変革を促す
ものづくりソリューションエキスパートとして
次代を切り拓く世界のあらゆるお客様とともに
デジタル社会の心躍る価値創造に貢献します

タグライン

To be the Sharpest



最尖端を、世界へ。





POINT 電子部品事業の売上がV字回復したことで前期比大幅な増収増益となった。

連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科目	当期 2019年12月31日現在	前期 2018年12月31日現在
資産の部		
流動資産	36,030	29,345
固定資産	44,391	37,474
有形固定資産	41,324	35,081
無形固定資産	500	464
投資その他の資産	2,566	1,927
資産合計	80,421	66,820
負債の部		
流動負債	16,468	13,905
固定負債	14,157	9,069
負債合計	30,626	22,974
純資産の部		
株主資本	48,819	43,336
資本金	10,968	8,522
資本剰余金	10,513	8,067
利益剰余金	27,337	26,746
自己株式	△ 0	△ 0
その他の包括利益累計額	909	439
非支配株主持分	66	69
純資産合計	49,795	43,845
負債純資産合計	80,421	66,820

連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

科目	当期 2019年1月1日から 2019年12月31日まで	前期 2018年1月1日から 2018年12月31日まで
売上高	54,019	52,674
売上原価	38,550	38,291
売上総利益	15,468	14,383
販売費及び一般管理費	13,962	13,664
営業利益	1,505	719
営業外収益	359	392
営業外費用	482	451
経常利益	1,382	660
特別利益	496	—
特別損失	534	1,907
税金等調整前当期純利益(△は損失)	1,344	△ 1,247
法人税等合計	421	631
非支配株主に帰属する当期純利益(△は損失)	△ 2	3
親会社株主に帰属する当期純利益(△は損失)	925	△ 1,882

連結キャッシュ・フロー計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

科目	当期 2019年1月1日から 2019年12月31日まで	前期 2018年1月1日から 2018年12月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,994	4,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,485	△ 9,296
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,937	4,090
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 136	△ 198
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	5,309	△ 1,033
現金及び現金同等物の期首残高	6,872	7,905
現金及び現金同等物の期末残高	12,182	6,872

株式の状況

(2019年12月31日現在)

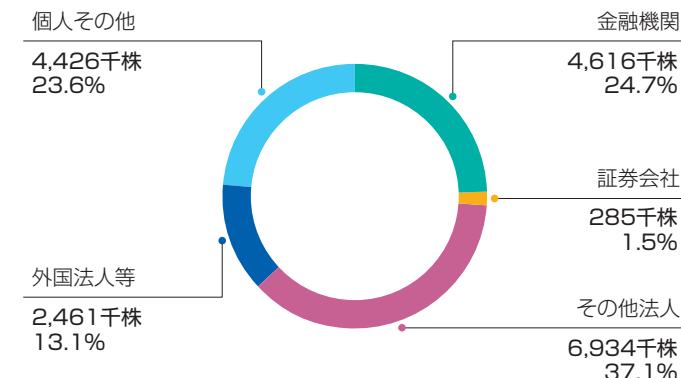
発行可能株式総数 20,000,000株
 発行済株式の総数 18,722,800株
 株主数 5,977名
 大株主(上位10名)

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
株式会社ディー・エム・シー	6,821,400	36.43
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,939,700	10.36
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,211,200	6.46
第一精工従業員持株会	606,780	3.24
小西英樹	498,800	2.66
BNYM SA/INV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS MILM FE	416,350	2.22
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託B口)	302,600	1.61
資産管理サービス信託銀行株式会社(年金特金口)	176,600	0.94
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	165,200	0.88
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800	157,500	0.84

(注) 1. 持株比率は自己株式(350株)を控除して計算しております。
 2. 大株主の小西英樹氏につきましては、2019年6月27日に逝去されましたが、2019年12月31日現在、名義変更手続きが未了のため、株主名簿上の名義に基づき記載しております。

所有者別株式分布状況

(2019年12月31日現在)



会社概要

(2019年12月31日現在)

商号 第一精工株式会社
 設立 1963年7月10日
 本社所在地 〒612-8024
 京都市伏見区桃山町根来12番地4
 資本金 109億6,800万円
 従業員数 単体: 2,088名 連結: 5,928名
 主要取引銀行 京都銀行、三菱UFJ銀行、
 三井住友銀行、みずほ銀行

役員

(2020年3月27日現在)

代表取締役社長 土山 隆治
 常務取締役 緒方 健治
 常務取締役 原田 隆
 常務取締役 田籠 康利
 取締役 原 昭彦
 取締役(監査等委員) 橋口 純一 *
 取締役(監査等委員) 庭野 修次 *
 取締役(監査等委員) 中田 均 *
 *(社外)